

銅箔檢測系統 (Copper Foil Inspection system)

銅 箔

● 系統功能

應用: 電解銅箔、壓延銅箔、FCCL、RCC及鋁箔等捲裝基材外觀瑕疵檢測

檢測項目: 針孔、墊傷、氧化、粒銅、刮傷、褶皺、結晶、銅粉、凹凸、水痕等等

檢測方式: 以高解析度線性CCD進行捲裝動態製程檢測

檢測速度: 線速可達50米/分

警示方式: 警示燈及警示音效或自動標籤紙黏貼標示

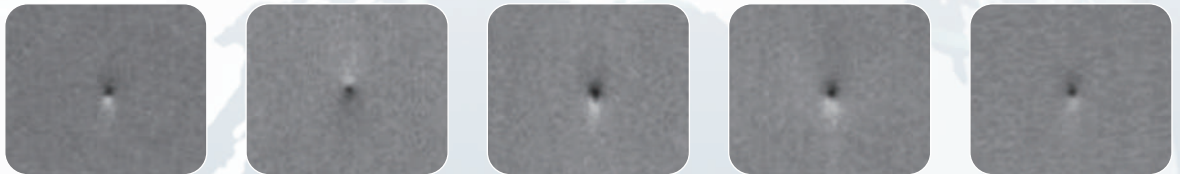
檢測精度: 50um(表面)、10um(針孔)

延伸應用: 製程遠端監控管理系統及品質分析，SIPPIS查詢系統配合檢測系統可以協助企業建立完整的製程監控與品質管理機制，節省人工成本及落實品質管理。

並可以提供遠端查詢、資料彙整保存以整合多條產線，提供生產、品管至行銷完整的產品狀態。

● 影像範例

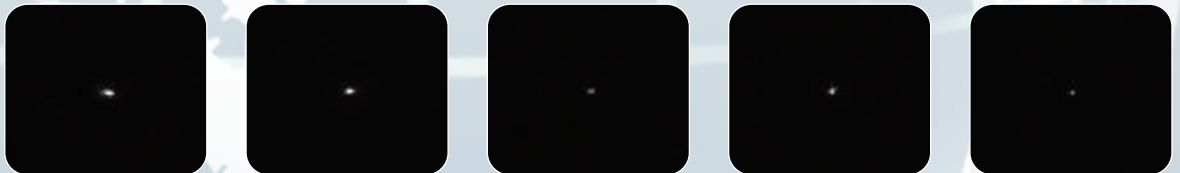
墊傷



粒銅



針孔



銅粉



水痕



結晶

